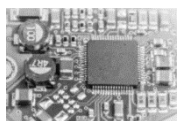


(1) 極短パルスレーザーとめっきによるパワー半導体ガラス基板のマスクレス配線工法開発

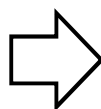
1. 背景 パワー半導体の需要と開発が活発化



問題点



従来のプラスチック基板では耐熱性が不足 ✕



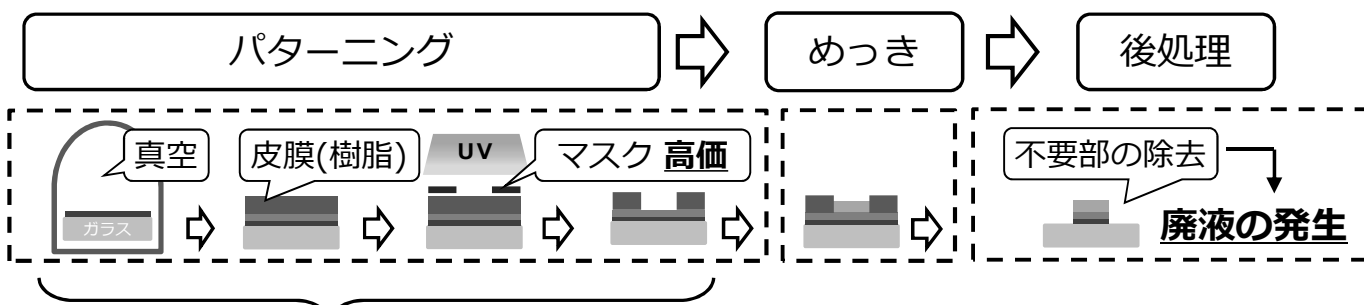
◎ **ガラス基板**
有望

- 優れた熱的安定性
- × 製造コスト

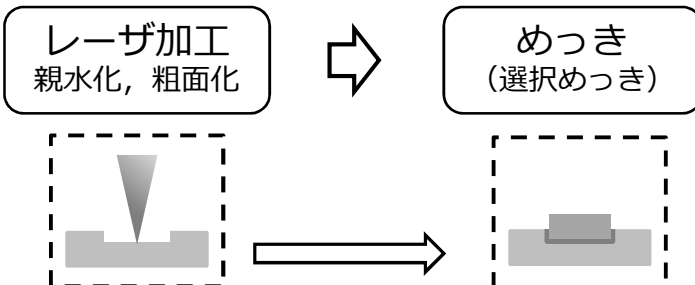
2. 事業内容 **低コストでガラス基板を製造するための配線工法**の開発

従来

- ・多数の工程が必要
- ・環境問題（廃液の発生）

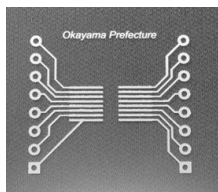


新技術



大幅なコストダウンを実現

微細な配線を自在に形成



- **高い信頼性**：
めっきとガラスの密着性良好
- **広い適用分野**：
プラスチック、セラミックス等にもめっき可能

3. 効果

- 加工技術の高付加価値化
- 生産性、国際競争力の向上
- 市場の創出による地域経済の活性化

4. 成果の展開

- 電気・半導体メーカーにおいて、実用化に向けての評価を開始
- フレキシブルデバイスや装飾品への応用